

Konformitätserklärung

Bezug:

Richtlinie 2011/65/EU „RoHS“ vom 08.06.2011

Elektro- und Elektronikgeräte einschließlich Kabeln und Ersatzteilen dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn die zulässigen Höchstkonzentrationen folgender Stoffe nicht überschritten werden:

0,1 Gewichtsprozent je homogenen Werkstoff: Blei, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP) oder 0,01 Gewichtsprozent Cadmium je homogenen Werkstoff.

umgesetzt in deutsches Recht durch ElektroStoffV

Richtlinie 2002/96/EG „WEEE“ vom 27.01.2003

Reduzierung der Abfallmenge durch Vermeidung, Wiederverwertung und Recycling von Altgeräten.

Kennzeichnung der nach dem 13.08.2005 in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte.

Selektive Behandlung lt. Anhang III, 1.c) Leiterplatten von Mobiltelefonen generell und sonstige Geräte, wenn die Oberfläche der Leiterplatte >10 cm²

umgesetzt in deutsches Recht durch ElektroG

Richtlinie 2000/53/EG „Altfahrzeuge“ vom 18.09.2000

Vermeidung von Fahrzeugabfällen, Verringerung der Abfallbeseitigung, Verbesserung der

Umweltschutzleistung aller in den Lebenskreislauf von Fahrzeugen einbezogenen Wirtschaftsbeteiligten.

Kein Pb, Hg, Cd und CrVI in Werkstoffen oder Bauteilen von Fahrzeugen, die nach dem 01.07.2003 in

Verkehr gebracht werden; Ausnahme Anhang II für Pb als Lötmedium in elektronischen Leiterplatten und sonst. Anwendungen.

umgesetzt in deutsches Recht durch AltfahrzeugV

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir für Leiterplatten mit „bleifreier“ Oberfläche (z. B. bleifreies HAL, Ni/Au, Sn, Ag und OSP) die Konformität mit den o. g. EU-Richtlinien und den deutschen Umsetzungen.

Eine Umstellung auf bleifreie Oberfläche erfolgt nur auf Kundenwunsch und -freigabe.

Die o.g. bleifreien Oberflächen können jederzeit als Alternative zu Hot Air Levelling gefertigt werden.

Die RoHS- Konformitätserklärungen unserer am Endprodukt Leiterplatte beteiligten Lieferanten liegen vor.

Wetter, den 01.08.2017

Schoeller Electronics Systems GmbH


M. Keuthen


i. A. R. Junk

<mailto:r.junk@se-pcb.de>